

2015年(平成27年)9月15日(火曜日)

日 刊

電 波 新 聞

発行所 電波新聞社

東京本社
東京都品川区東五反田1-11
15 千141-8715
⑧03(3445)6111(大代表)

大阪本社
大阪市中央区北區3-2-25
(京阪淀屋橋ビル6階) 千541-0041
⑧06(6203)3361(大代表)

西部本社
福岡市博多区博多駅前2-13
-23(扇寿ビル) 千812-0011
⑧092(431)7411(大代表)

©電波新聞社 2006

千住金属工業

セミコン台湾で先端の接合技術ソリューションを紹介

2日から4日まで台北で開催された「セミコン台湾2015」で千住金属工業は、ブースや技術セミナー、またパネルディスカッションで先端の接合技術ソリューションを紹介した。「先端半導体パッケージングで特に重要なことは、狭ピッチインターコネクト」とい

へはんだ材料ソリューション。

◇

ユーシオンを完成させ

センブリブ（Ni）ボールを含有し、新ジェット・ディスプレイスに対するプリフォームやソルダーペーストがある。

さらに、WLPアセンブリの接合部を保護する熱硬化性樹脂タイプのフッ素樹脂（FEP）や、30μm微細ソルダーボールの使用により、60μmピッチが実現する。PPS工法（Powder Sheet Process）では、ソルダーパワダースートの使用によって50μmピッチ以下が実現するだろう。

狭ピッチインターコネクトに向け

ピッチサイズに最適材料を提供

う千住金属工業台湾支店の黄智堯副支店長に聞いた。

黄智堯・台湾副支店長

を業界に先駆けて開発、提案し続けてきた。

高熱サイクルおよび落下試験性能を持つソルダーボール、ならびにBGAダーペーストなどである。おおよそチップ用、およびフラックス、C4バン（印刷プロセスでは3Dニーズにも対応）の要求に際する微細ソルダーボールおよび接合強度を増すソルダーペーストの使用により80μmピッチが実現する。また3Dニーズに対して提供される。



「セミコン台湾2015」のセッションで話す黄副支店長

今、2・5D、3Dからエンベドッド・パッケージに至る様々なアッパースト、そして信頼性の高いピッチが実現する。また3Dニーズに対して提供される。